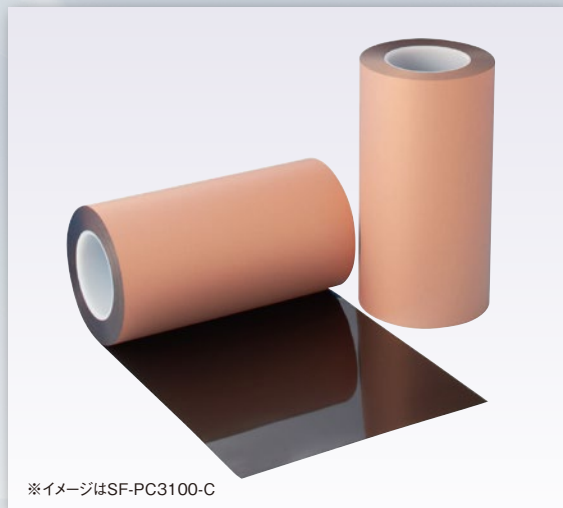


高速伝送FPC用 / 高速伝送FPC用薄型タイプ



※イメージはSF-PC3100-C

SF-PC[®]3100-C SF-PC[®]3300-C

FPCの高速伝送化に対応可能なシールドフィルム

シールド層に圧延銅箔を使用することにより、
これまで以上に優れた高速伝送特性と高シールド特性を実現しました。

特徴

▶ 高速伝送特性・高シールド特性

TATSUTA製品の中でもトップクラスの性能

▶ 形状保持性

圧延銅箔を使用することにより形状保持性を有する

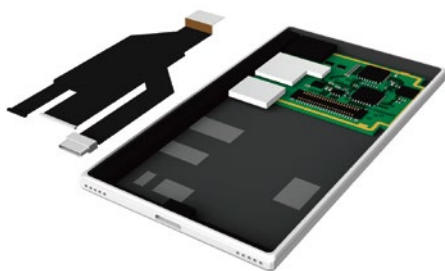
UL登録内容

UL94 V-0 (Kapton50Hとの組み合わせ)

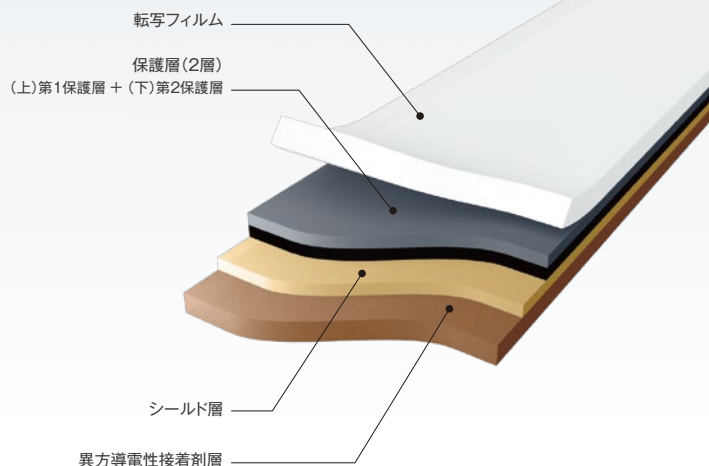
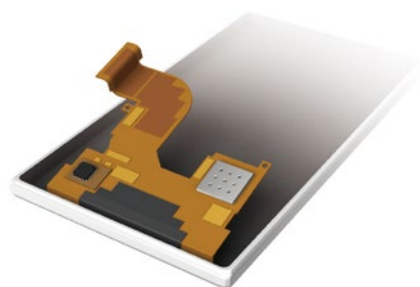
※Kapton®は米国デュポン社の登録商標です

こんなところで活躍します

インターフェースの高速化に対応



圧延銅箔シールド層による形状保持性で FPCの反発力抑制



代表スペック	SF-PC3100-C	SF-PC3300-C
転写フィルム厚み	50μm(透明)	50μm(透明)
製品総厚み(プレス後)	20μm	17μm
保護層厚み	5μm	6μm
シールド層厚み	5.5μm	2μm
異方導電性接着剤層厚み	9μm	9μm
接着強度	3.0N/cm以上	3.0N/cm以上
製品ライフ(冷蔵)	6ヶ月	6ヶ月